

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 4 区分

【発行日】平成 24 年 5 月 17 日 (2012.5.17)

【公開番号】特開 2010-259199 (P2010-259199A)

【公開日】平成 22 年 11 月 11 日 (2010.11.11)

【年通号数】公開・登録公報 2010-045

【出願番号】特願 2009-105472 (P2009-105472)

【国際特許分類】

H 0 2 K 5/18 (2006.01)

H 0 2 K 21/22 (2006.01)

H 0 2 K 11/00 (2006.01)

【F I】

H 0 2 K 5/18

H 0 2 K 21/22 M

H 0 2 K 11/00 X

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 3 月 23 日 (2012.3.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 6】

しかるに、このようなモータ本体部 3 0 のハウジング 3 1 の配置及び構成とすることにより、ハウジング 3 1 に内包された制御基板 2 8、ステータアセンブリ 2 2 が発熱してもハウジング 3 1 のハウジング本体 3 1 の外面 (特にその側方外面) が送風路 4 0 に表出しているため、これらの制御基板 2 8 やステータアセンブリ 2 2 から生ずる熱が熱伝導性の高いハウジング 3 1 に伝達され、更に、ハウジング 3 1 のハウジング本体 3 1 a の外面から放熱することができるので、ヒートシンク等の放熱装置を用いなくても簡易な構造で駆動モータ 3 の放熱が可能となる。これに伴い、部品点数の削減による送風ユニット 1 の相対的な製造コストの削減、駆動モータ 3 ひいては送風ユニット 1 の更なる小型化を図ることができる。